

[会員限定] 2023年度第6回 WBG実装WG研究会

【開催日】2024年2月16日(金)13:30~18:00

【会場】大阪大学 産業科学研究所 インキュベーション棟1階
講義室(I-117)

大阪大学産業科学研究所F3D協働研究所研究所におけるF3D実装コンソーシアム活動におきまして、2023年度期における当該コンソーシアム活動傘下のWBG実装WG (WGB-WG)研究会を下記の内容で開催いたします。

【プログラム】 【パワー半導体デバイスの実装, 応用および課題】

13:30-13:35 開会挨拶

大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

所長・特任教授 菅沼克昭 氏

ハイブリッド開催
(阪大産研+ZOOM)

13:35-14:25 講演①

「10 kV高電圧高周波にむけたSiCパワーデバイスの新しい応用」

ネクスファイ・テクノロジー株式会社

大阪大学大学院工学研究科 SiC応用技術共同研究講座

特任准教授 奥田 貴史 氏

14:25-15:15 講演②

「800V車載インバータを実現するパワーモジュール樹脂絶縁構造開発」

株式会社日立製作所 研究開発グループ グリーンインフラインノベー
ションセンタ コネクティブドライブ研究部 G1D1ユニット(絶縁技術担当)

主任研究員 楠川 順平 氏

15:15-15:25 休憩・講師との名刺交換会

15:25-16:15 講演③

「SiCパワー半導体モジュールパッケージの絶縁技術開発と応用」

大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所

特任教授 匹田 政幸 氏

16:15-16:45 新会員企業の自社紹介

① RIMTEC株式会社 ② 株式会社コベルコ科研

17:00-18:00 講演者を交えた意見交換会

申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/12xv1MzDodg8wTE0JOmtxTiiU-6bK_SRyBti951S9SeA/edit



お申込みは
こちらから！

会場アクセス Web: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/access/>

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 WBG-WG事務局

(TEL/FAX: 06-6879-4295/E-mail: hikita.masayuki@sanken.osaka-u.ac.jp) 匹田 政幸

主催: 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所

後援: 一般財団法人大阪大学産業科学研究協会